PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 162, DE 27 DE JUNHO DE 2012.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 13 a 16 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, e o que consta no Processo MDIC nº 52000.001052/2005-10, de 13 de janeiro de 2005,

RESOLVEM:

- Art. 1º O Processo Produtivo Básico para os BENS DE INFORMÁTICA, industrializados na Zona Franca de Manaus, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 18, de 1º de fevereiro de 2011, passa a ser o seguinte:
 - I montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;
- II montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e
- III integração das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II acima.
- \S 1º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, no País, exceto a etapa descrita no inciso III que não poderá ser objeto de terceirização.
- $\S 2^{\circ}$ Quando o BEM DE INFORMÁTICA a que se refere esta Portaria não contiver placas de circuito impresso com componentes montados, a etapa constante do inciso I poderá ser dispensada, permanecendo obrigatórias as demais etapas constantes dos incisos I e II.
- § 3º Até 31 de dezembro de 2012, não descaracteriza o atendimento ao Processo Produtivo Básico definido nesta Portaria a inclusão, em um mesmo corpo ou gabinete de um bem de informática, de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação que não tenham cumprido o Processo Produtivo Básico estabelecido nesta Portaria.
- § 4º A partir de 1º de janeiro de 2013, as FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONVERSORES DE CORRENTE CONTÍNUA (CA-CC) OU CARREGADORES DE BATERIA, quando forem externas ou quando estiverem contidas no mesmo corpo ou gabinete de um BEM DE INFORMÁTICA, deverão ser produzidos atendendo às etapas estabelecidas no **caput** deste artigo, num percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), tomando-se por base a quantidade total produzida, no ano calendário.
- Art. 2° Ficam temporariamente dispensados de montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:
- Banco de martelos para impressoras de linha
 Cabeça de impressão térmica
 Conjunto de espelhos e conjunto óptico para leitor de código de barras
 Gabinete superior com visor de vidro destinado à fabricação de leitor de código de barras vertical, fixo, do tipo mesa ou balcão
 Mecanismo impressor com largura de impressão de até 6 (seis) cm
 Mecanismo impressor e leitor de cartão magnético para dispensadores automáticos de papel-moeda cash dispenser ou terminal de auto-atendimento ATM (Automatic teller machine)

Mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético

- 8. Mecanismo para aparelhos de fac-símile com impressão por sistema térmico ou a **laser**, mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagens **scanner**, mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagens **scanner** utilizado em subconjuntos depositários de cheques e envelopes
- 9. Mecanismo para impressora a **laser**, LED Diodos emissores de luz ou LCS Sistema de cristal líquido **engine**
- 10. Microprocessador montado em placa com barramento de conexão à placa mãe com mais de duzentas vias, condicionadas ou não em cartucho
- 11. Modulador/demodulador de rádio freqüência denominado **tuner**
- 12. Módulo SOM (**System on module**) com circuito lógico e/ou de rádio freqüência integrado próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície SMT (**Surface Mounted Technology**)
- 13. Módulo de comunicação **Bluetooth** próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície SMT (**Surface Mounted Technology**)
- 14. Módulo **display** de cristal líquido LCD, com placa de controle integrada
- 15. Módulo GPS Sistema de posicionamento global
- 16. Módulo leitor de cartão inteligente smart card
- 17. Módulo leitor de código de barras para terminais de auto-atendimento
- 18. Módulo dispositivo ou subconjunto de mostrador de cristal líquido, plasma ou diodo emissor de luz LED e outras tecnologias de **displays**
- 19. Módulo sensor de proximidade
- 20. Módulo Sensor Biométrico
- 21. Módulo Sensor Sísmico
- 22. Módulo tiristor simétrico de potência, tipo SGCT (**Symmetrical Gate Commutated Thyristors**), com características técnicas de 6.500 V e 400-800A, para utilização em Inversor de Freqüência de Média Tensão
- 23. Padrão de grandezas elétricas e sensor fotoelétrico para aquisição de pulsos
- 24. Painel de operação e controle para impressoras, mesmo incorporando dispositivo de visualização
- 25. Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente função de processamento central, do tipo industrial, que suporte temperaturas de operação superiores a 60° C, para utilização em sistemas de medição de energia elétrica
- 26. Teclado e visor para aparelhos de **fac-símile**
- 27. Tubo de raios catódicos policromático, mesmo com bobina de deflexão e dispositivos de ajuste de convergência incorporados
- 28. Tubo de raios catódicos policromático, mesmo com bobina de deflexão, dispositivos de ajuste de convergência e transdutores com cabo de comunicação incorporados, para monitores de vídeo com tela tipo **touch screen**
- 29. Unidade de fita magnética tipo DAT Fita digital de áudio
- 30. Subconjunto óptico montado destinado às unidades de saída por vídeo, para máquinas automáticas para processamento de dados, com tecnologia de micro-espelho e processador digital de luz, contendo disco de cores do tipo Disco de Newton, lâmpada ou LCD ou LED, lentes e espelhos ópticos.
- 31. Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de transmissão e recepção de sinais infra-vermelhos em monitores de vídeo igual ou acima de 40" com função de tela sensível ao toque.
- 32. Unidade de disco magnético.
- 33. Unidade de disco óptico.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no **caput** ficam dispensados da montagem, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, os leitores de cartão de memória e as placas e partes eletromecânicas sem função ativa, com ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente conectores, entradas de USB, diodos emissores de luz – LED (**Light Emitting Diode**), chaves liga-desliga ou cabos, utilizados unicamente como extensão de função já implementada na placa-mãe.

- § 2º As placas de interfaces de comunicação com tecnologia sem fio (**Wi-Fi**, **Bluetooth**, **WiMax**), destinadas aos BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, deverão atender ao seguinte cronograma de montagem tomando-se como base a quantidade dessas placas utilizadas no ano calendário:
 - I de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2010: dispensado.
 - II de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011: 20% (vinte por cento);
 - III de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50% (cinquenta por cento); e
 - IV de 1º de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).
- § 3º Caso o percentual estabelecido no inciso II do §2º não seja alcançado no período previsto, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual, em unidades produzidas, até 31 de dezembro de 2012, sem prejuízo das obrigações correntes.
- § 4º As câmeras de vídeo ou placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de câmera de vídeo utilizadas na produção de MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA "ALL IN ONE", deverão atender ao seguinte cronograma:
 - I para o período anterior a 16 de fevereiro de 2012: dispensada; e
- II para o período posterior a 16 de fevereiro de 2012: seguirá o Processo Produtivo Básico específico estabelecido em Portaria Interministerial.
- Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim, o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.
 - Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 5º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 18, de 1º de fevereiro de 2011.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MARCO ANTONIO RAUPP

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação